

<<手机原理与维修>>

图书基本信息

书名：<<手机原理与维修>>

13位ISBN编号：9787111375449

10位ISBN编号：7111375440

出版时间：2012-6

出版时间：机械工业出版社

作者：刘勇

页数：144

字数：240000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<手机原理与维修>>

内容概要

《全国高等职业教育规划教材：手机原理与维修》根据高职高专电子信息、通信技术、应用电子技术等专业教学实际需求，结合作者十几年来企业工作经历和实际教学经验进行编写。

《全国高等职业教育规划教材：手机原理与维修》共11章，主要内容包括：全面认识手机，手机的常见功能和参数，常见手机的拆装，手机主要元器件的识别与检测，手机专用工具仪器的使用，手机常见信号的测量，手机元器件的焊接，手机整机电路的简析，手机软件的维护，手机故障的检测及维修方法。

根据高职高专技能型人才培养要求，本书合理安排知识内容和技能训练，重视高技能人才的培养。本书参考学时90学时。

本书可作为高职高专电子信息类专业教材，也可作为通信维修员职业资格证书的培训教材或从事手机维修行业人员的参考用书。

<<手机原理与维修>>

书籍目录

第一篇 基础篇

前言

第1章 认识手机

1.1 绪论

1.2 移动通信终端介绍

1.2.1 移动电话简介

1.2.2 手机的分类

1.3 手机主流厂商及主打机型介绍

1.3.1 手机品牌简介

1.3.2 主流手机品牌简介

1.4 手机标贴信息

1.4.1 主标贴信息

1.4.2 进网许可证信息

习题1

第2章 手机常见功能及参数介绍

2.1 手机基本参数

2.1.1 手机类型

2.1.2 手机制式和手机频段

2.1.3 数据传输模式

2.1.4 手机屏幕参数

2.1.5 手机铃声参数

2.1.6 手机操作系统

2.1.7 手机CPU参数

2.1.8 手机内存参数

2.1.9 手机电池参数

2.1.10 产品外观参数

2.2 手机常用功能

2.2.1 手机基本功能

2.2.2 手机数据功能

2.2.3 手机拍摄功能

2.2.4 手机娱乐功能

2.2.5 手机网络功能

2.2.6 手机应用功能

2.3 手机常用软件

2.3.1 系统管理软件

2.3.2 安全软件

2.3.3 网络软件

2.3.4 地图导航

2.3.5 影音播放

2.3.6 商务办公软件

习题2

第3章 手机拆装技巧

3.1 手机拆装技巧

3.1.1 拆装前的准备

3.1.2 手机拆装步骤

<<手机原理与维修>>

3.1.3手机拆装注意事项

3.2 直板手机的拆装

3.3 滑盖式手机的拆装

3.4 翻盖式手机的拆装

习题3

第4章 手机维修简介

4.1 手机维修简介

4.1.1 手机维修费用构成

4.1.2 手机维修的级别分类

4.1.3 手机维修的基本流程

4.2 手机三包介绍

4.2.1手机三包的执行时间

4.2.2手机三包的主要内容

4.2.3实行三包的手机产品

4.2.4手机三包凭证内容

4.2.5手机三包的性能故障表

4.3 手机职业标准

4.3.1 职业概况

4.3.2 基本要求

4.3.3 用户通信终端维修员职业标准（中级）

习题4

第二篇 维修工具及仪器篇

第5章 手机常见元器件

5.1 常用元器件

5.1.1 基本元器件

5.1.2 特殊元器件

5.2 常用集成电路

5.2.1 SOP封装集成电路

5.2.2 QFP封装集成电路

5.2.3 BGA封装集成电路

习题5

第6章 手机维修专用工具及仪器

6.1 专用维修工具

6.1.1 拆卸工具

6.1.2 防静电恒温电烙铁

6.1.3防静电热风枪

6.1.4维修耗材

6.2 常用维修仪器

6.2.1 数字万用表

6.2.2 示波器

6.2.3 频谱分析仪

6.2.4 手机综合测试仪

6.2.5 通用编程器的使用

习题6

第7章 常见手机信号测量

7.1 控制信号的测量

7.1.1 常见射频控制信号的测量

<<手机原理与维修>>

7.1.2 常用逻辑控制信号的测量

7.2 时钟信号的测量

7.3 常见低频信号的测量

7.3.1 I/Q信号的测量

7.3.2 语音信号的测量

7.4 射频性能测试

7.4.1 射频性能参数

7.4.2 射频综合测试

习题7

第8章 手机元器件的焊接方法

8.1 手机维修用焊接工具

8.1.1 恒温烙铁

8.1.2 热风枪

8.2 电阻、电容、三极管等小元件的焊接方法

8.2.1 焊接前的准备

8.2.2 小元件的拆卸

8.2.3 小元件的焊接

8.3 QFP、SOP等集成电路的拆卸焊接方法

8.3.1 焊接前的准备

8.3.2 QFP、SOP集成电路的拆卸

8.3.3 QFP、SOP集成电路的焊接

8.4 BGA集成电路的拆卸焊接方法

8.4.1 焊接前的准备

8.4.2 BGA芯片的拆卸

8.4.3 BGA芯片的安装

习题8

第三篇 维修篇

第9章 手机的整机电路

9.1 手机的整机框图

9.1.1 手机的结构框图

9.1.2 各部分的作用

9.2 射频电路构成

9.2.1 接收电路

9.2.2 发射电路

9.2.3 时钟电路

9.3 其他电路

9.3.1 逻辑控制电路

9.3.2 供电充电电路

9.3.3 手机的开关机过程

9.4 摩托罗拉系列 V3手机信号流程分析

9.4.1 接收通路

9.4.2 发射通路

9.4.3 逻辑控制部分

9.4.4 音频电路

9.4.5 供电电路

习题9

第10章 手机的软件维护

<<手机原理与维修>>

10.1 手机的软件

10.1.1 手机的软件

10.1.2 手机软件的故障现象

10.2 软件故障的处理方法

10.2.1 免拆机软件维修

10.2.2 拆机软件维修

习题10

第11章 手机故障的检测及维修方法

11.1 手机故障的检测

11.1.1 故障产生的原因

11.1.2 手机故障的检测步骤及检测方法

11.2 手机故障维修

11.2.1 不开机

11.2.2 信号故障

11.2.3、显示故障

11.2.4 不读卡

11.2.5 音频故障

11.2.6 充电故障

11.2.7 按键故障

11.2.8 V998维修实例

习题11

附图1：V998电路原理图

附图2：V998元件分布板图

附图3：N3310电路原理图

参考书目

<<手机原理与维修>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>